

锦州神工半导体股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动

方案的半年度评估报告

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实履行社会责任，公司于 2026 年 3 月 21 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。2026 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

一、聚焦做强主业，提高核心竞争力

神工股份是国内极少数具备“从晶体生长到硅电极成品”完整制造能力的一体化厂商，能够大规模、高品质、高可靠、广覆盖地向全球下游厂商提供大直径硅材料产品，在全球细分领域处于第一梯队。公司积极响应快速增长的国内市场多元化需求，在半导体材料及零部件国产化进程中发挥了独特作用。

2026 年上半年，公司实现营业收入 21,640.56 万元，同比增长 3.78%；归属于上市公司股东的净利润 4,108.54 万元，较去年同期降低 15.87%。

单位：万元 币种：人民币

经营指标	2024 年半年度	2025 年半年度	2026 年半年度
营业收入	12,522	20,853	21,641
净利润	476	4,884	4,109
经营活动产生的现金流净额	7,837	6,751	13,412
研发投入总额/营业收入	9.84%	5.38%	7.88%

近三年同期，公司经营稳健，主要财务指标稳中有升。一方面，全球半导

体产业景气度从上一轮周期开始低谷攀升，公司同时受益于全球半导体产业链和中国本土半导体国产化的拉动；另一方面，公司着力调整产品结构并优化客户结构，已经从单一的上游材料企业成长为“材料+零部件”企业，业绩稳定性提升，成长空间扩大。研发投入保持在稳定水平，匹配了公司作为科技创新型企业需要在产业快速发展中兼顾研发和量产的现实条件。

报告期内，大直径硅材料业务受到海外市场景气度提升带动，实现营业收入 13,513.72 万元，同比增长达 46.05%；

硅零部件业务受下游客户采购计划调整的影响，报告期内实现营业收入 6,899.07 万元，同比减少 38.57%。公司在按照既定战略持续扩充产能的同时，针对性地优化产能配置和客户结构，已取得成效；

半导体大尺寸硅片业务受益于行业整体回暖和竞争格局改善影响，已经实现面向重点客户的小批量出货，利基细分市场培育亦取得显著成果，开工率有所提升。报告期内，该业务实现营业收入 1,110.33 万元，同比增长达 268.98%，毛利率为-5.05%，接近转正。

募投项目方面，“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”累计投入金额为 8,156.57 万元，已顺利落地并形成有效产能，相关产能已正式投入运营，对公司主营业务形成有效补充与协同支撑，为公司产能布局优化及可持续发展奠定了坚实基础，发挥了积极作用。

二、共享发展成果，完善投资者回报机制

公司已于 2026 年 6 月 9 日向全体股东每股派发现金红利 0.185 元（含税），现金红利总额为 31,389,083.20 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.76%。符合《锦州神工半导体股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》之目标。

当前，全球半导体行业正在蓬勃发展，中国半导体产业产能扩张尤为迅猛，公司作为上游半导体材料和零部件企业，有望受益于下游终端客户的持续需求带动，已经迎来发展机遇期，需要集中资源扩充产能、研发新产品并积极拓展全球客户，因此资本开支较大；另一方面，中国半导体材料和零部件行业的国产化进程已经进入深水区，积极开展对外投资和并购，亦是行业高质量发展的

必然要求，公司作为上市公司亦将在既有的内涵式发展模式之外，充分借助资本市场的力量，展开外延式发展。综上，公司资本配置策略在一段历史时期内，仍将匹配公司作为成长期企业的特点，优先考虑构建长期稳定的研发生产能力并取得全球行业竞争优势地位。

2026 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，适时提高分红频次，提升广大投资者的获得感。

三、加快发展新质生产力，创新配置生产要素

公司将以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。加强产学研合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

报告期内，公司研发支出累计投入 1,705.88 万元，同比增长 52.03%；公司及下属子公司共申请专利 16 项，获得专利授权 5 项；公司累计获得专利授权 124 项，同比增长 21.57%。

四、提升信披质量，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，持续完善对外沟通渠道，通过多元方式与投资者保持沟通交流。

报告期内，公司已在定期报告发布一周内，通过上证路演中心正式召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流。此外，公司还致力于在加强信披质量的前提下，通过上证 e 互动平台、电话、邮箱等日常渠道与广大投资者保持畅通交流，加强沟通频次，帮助投资者更好地了解公司、认同公司，报告期内公司共披露《投资者关系活动记录表》6 次。

未来，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，不断强化精细化管理，持续完善制度建设，力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

五、深化公司治理，保障规范运作

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，建立健全各项内控制度，并组织制度的企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高，及时传递分享（监管）政策动态，提升董监高履职技能、合规知识储备。

2026 年上半年，公司共召开 3 次股东会、5 次董事会、11 次董事会专门委员会，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

报告期内，公司继续强化规范治理基础。公司制定了《锦州神工半导体股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《锦州神工半导体股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等 2 项治理制度。公司组织了 2 次独立董事调研活动，来公司实地了解经营情况，聚焦市场形势分析与业务结构调整优化、风险管理与内部控制体系建设等关键问题，提升战略引领和管控能力，推动公司整体治理水平的提升。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。公司全力支持董事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

自《行动方案》正式披露以来，公司坚持创新引领，积极按照《行动方案》有关指引推动各项工作落地、落实，致力于进一步提升公司经营质量，打造发展新动能。

未来，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，不断强化精细化管理，持续完善制度建设，力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

欢迎广大投资者就公司经营发展及“提质增效重回报”行动方案的提出意

见建议，持续提升上市公司发展质量。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日